

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
E04C 1/00 (2006.01)



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200920133261.5

[45] 授权公告日 2010 年 3 月 31 日

[11] 授权公告号 CN 201433498Y

[22] 申请日 2009.7.3

[21] 申请号 200920133261.5

[73] 专利权人 翁履谦

地址 214101 江苏省无锡市锡山区芙蓉中三路 99 号科创园 9 号楼 106 室无锡清锡科技有限公司

[72] 发明人 翁履谦

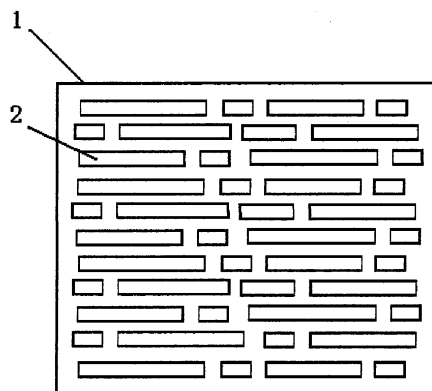
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

一种多排盲孔保温烧结砖或砌块

[57] 摘要

本实用新型公开了一种多排盲孔保温烧结砖或砌块，属于建筑墙体材料及产品领域。它包括砖或砌块体和该砖或砌块体上设置的盲孔。所述盲孔宽度为 4 毫米到 15 毫米，长度长于宽度，相邻孔之间肋的宽度为 3 毫米到 15 毫米。相邻盲孔之间相互交错。本实用新型能保证砌筑质量，方便施工，并能有效提高砖或砌块的隔热保温性能。



1. 一种多排盲孔烧结砖或砌块，包括砖或砌块体（1）和该砖或砌块体上设置的盲孔（2），其特征在于所述盲孔（2）宽度为 4 毫米到 15 毫米，盲孔（2）长度长于宽度，相邻盲孔（2）之间肋的宽度为 3 毫米到 15 毫米，相邻两排盲孔（2）之间相互交错。

2. 根据权利要求 1 所述的多排盲孔烧结砖或砌块，其特征在于所述盲孔（2）形状为，矩形、椭圆形、梯形或腰形，并且不限于矩形、椭圆形、梯形或腰形。

一种多排盲孔保温烧结砖或砌块

一、技术领域

本实用新型涉及一种建筑墙体材料及产品，特别是一种多排盲孔保温烧结砖或砌块。

二、背景技术

烧结多孔薄壁保温砖或砌块，密度小，重量轻，导热低，传热系数小，节省资源、也节省制造和运输能源及建筑使用能源，能以单一材料达到墙体节能保温的效果。为使烧结多孔砖或砌块达到好的保温效果，砖或砌块上的孔的排布应为多排结构，砖或砌块的壁和肋的厚度需薄。目前国内外制造的烧结多孔薄壁保温砖或砌块，如国外的“勃罗顿”（poroton）砌块和国内 CN200720007296.5 的七排孔的保温烧结砖均为通孔砖。当砖或砌块的孔洞率大时，砖或砌块之间的通孔可能相互连通，增大了孔内空气的对流，不利于保温。同时孔洞率大的通孔砖或砌块在砌筑时砂浆容易掉入孔内，造成砖或砌块面上布浆不满，影响砌筑质量，带来施工不便。本实用新型克服了多排通孔砖的上述缺陷。

三、发明内容

本实用新型的目的在于提供一种能保证砌筑质量，方便施工，并能有效提高隔热保温性能的砖或砌块。这种多排盲孔保温烧结砖或砌块，包括砖或砌块体和该砖或砌块体上设置的盲孔。其特征在于所述盲孔宽度为 4 毫米到 15 毫米，盲孔长度长于宽度，相邻盲孔之间肋的宽度为 3 毫米到 15 毫米。相邻两排盲孔之间相互交错。盲孔形状为矩形、椭圆形、梯形或腰形，并且不限于矩形、椭圆形、梯形或腰形。

由于本实用新型的孔为盲孔，能防止砌筑时砂浆掉入孔内，因而能克服通孔砖布浆不满的问题，提高砌筑质量。同时盲孔能阻断砖或砌块之间孔的相互连通，减少了孔内空气的对流，有利于保温。

四、附图说明

本实用新型实施方式的结构示意图由以下附图给出。

图 1 是实施方式的俯视图。

附图中各标识表示：

1. 烧结砖或砌块体 2. 盲孔

图 2 是实施方式的剖面图。

附图中各标识表示：

1. 烧结砖或砌块体 2. 盲孔 3. 砖或砌块材料

以下结合附图将对实施方式作进一步地详细描述。

五、具体实施方式

图 1 示出的是砖或砌块的俯视图，它具有砖体 1，在该砖体 1 上开有十一排盲孔 2，相邻两排盲孔之间相互交错。盲孔 2 的形状为矩形，可以倒角或不倒角。图 2 示出的是砖或砌块的剖面图。它具有砖体 1，在该砖体 1 上开有十一排盲孔 2，下划线部分 3 为砖的材料。由于相邻两排盲孔之间相互交错，因此砖或砌块在不同部位的剖面图不同，但孔为盲孔的基本特征不变。

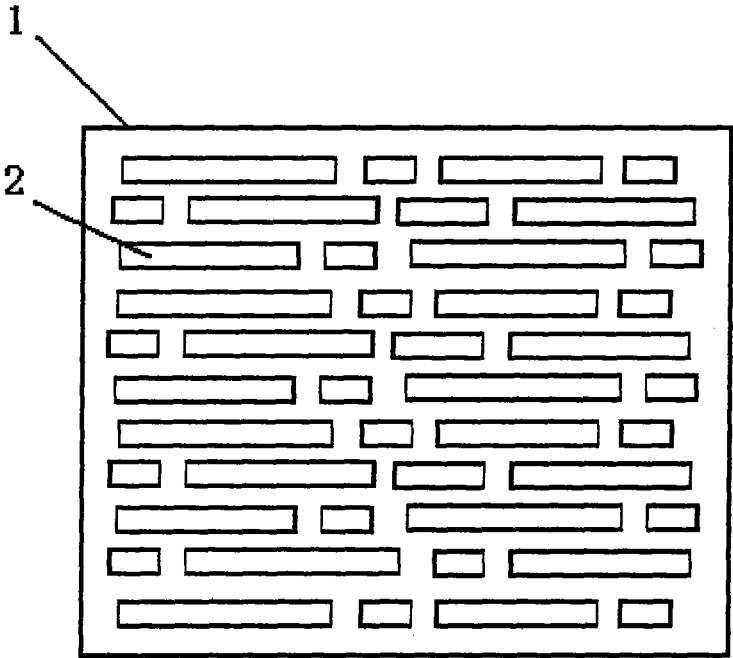


图 1

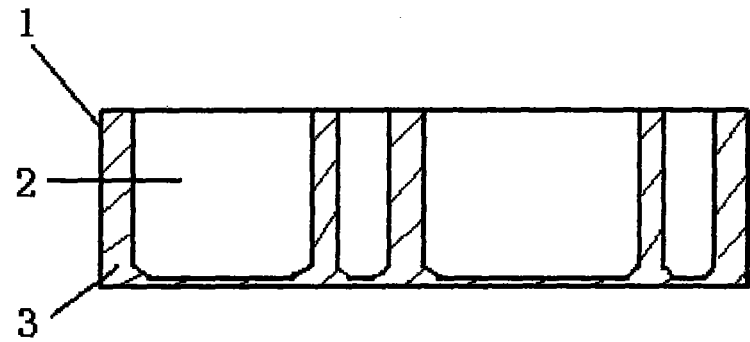


图 2